

主催：(一財)岡山セラミックス技術振興財団・(株)リガク・(株)大熊
共催：日本セラミックス協会中国四国支部・耐火物技術協会中国四国支部

X線を利用した最新解析セミナーⅡ-リガク

製造プロセス研究会の一環として、X線を利用した最新解析の情報をご提供するセミナーを次のとおり開催しますので、関係各位多数の御参加をお願いします。

日時

平成28年 3月18日(金) 13:30~16:00

会場

岡山セラミックスセンター セミナー室
備前市西片上 1406 番地 18

定員

50名

受講料

無料

申込方法

別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAXかメールにてご送信ください。
(一財)岡山セラミックス技術振興財団 担当：川端裕美(かわばた)
TEL 0869-64-0505 FAX 0869-63-0227
Email: erazoku@optic.or.jp

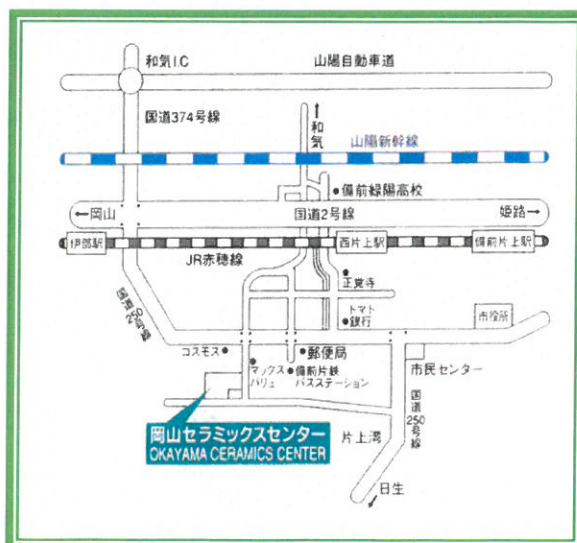
申込〆切

平成28年 3月11日(金)

アクセス

JR岡山駅から 約30km

- ・JR赤穂線で45分 西片上駅下車
徒歩約8分
- ・車で約1時間



プログラム

時 間	項目/概要
13:30-13:35	開会あいさつ 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 理事長 吉 鷹 啓
13:35-14:55	「X線の基礎とアプリケーション」 株式会社リガクX線機器事業部応用技術センター XRD 解析グループ 森 川 千 晶 【概要】測定条件や試料調製を含めたX線の基礎をご紹介します。また、今回実演で使用しますデスクトップX線回折装置MiniFlexを用いたアプリケーション例についてをご紹介します。
14:55-15:00	休憩
15:00-16:00	「デスクトップX線回折装置MiniFlex300による分析実演/デモ」 【概要】デスクトップX線回折装置MiniFlex300は100V電源で動作し、冷却水を内蔵しており、非常に簡便に使用できる可搬可能な分析装置です。環境試料、医薬品、機能性無機材料など、無機・有機材料問わず、様々な材料分野においてご活用頂いております。 MiniFlexの特長、操作方法、試料調製、定性分析などを含めた分析法のポイントについて、実機を操作しながらご紹介いたします。
16:00	閉会

* ご持参のサンプル測定可能（時間内にて）

* 固体/粉体（粒度が粗い試料は予め粉碎処理を行ってください。固体試料は、縦：35mm、横：70mm、厚さ：25mm 以内の大きさです。）

3月11日(金) 〆切 川端 行

FAX0869-63-0227

erazoku@optic.or.jp

X線を利用した最新解析セミナーⅡーリガク

平成 年 月 日

(一財)岡山セラミックス技術振興財団 御中

〒

住 所

会社名

申込者氏名

TEL

FAX

E-mail

以下のとおり参加申し込みます。

参加者氏名

氏 名	所属、役職	備考

デスクトップX線回折装置「MiniFlex300」の実演

・希望する

・希望しない

※どちらにも〇がない場合は「希望なし」と致します。

サンプル名、粉体or個体、大きさなど

*ご持参のサンプル測定可能(時間内にて)

*固体/粉体(粒度が粗い試料は予め粉碎処理を行ってください。固体試料は、縦:35mm、横:70mm、厚さ:25mm以内の大きさです。)